

DAFTAR PUSTAKA

- [1] A. W. N. Bagja Restu Muhammad, “Disain Dan Fabrikasi Mesin Sputtering Skala Laboratorium untuk Penumbuhan Film Tipis (Design and fabrication of Laboratory Scale Sputtering Machine for Thin Film Growth),” *Semesta Tek.*, vol. 20, no. 1, pp. 1–7, 2017.
- [2] B. A. Sidabutar and W. Djuriatno, “JURNAL INTAKE Pelapisan Logam Menggunakan Plasma,” pp. 129–134, 1928.
- [3] L. Santya, M. Miftah, V. Mandala, S. Saepudin, and D. Gustian, “Penerapan Metode Fuzzy Mamdani untuk Pendukung Keputusan Penentuan Jumlah Produksi Lantak Si Jimat,” *J. Rekayasa Teknol. Nusa Putra*, vol. 7, no. 1, pp. 35–41, 2019.
- [4] I. D. Depla, S. Mahieu, and J. E. Greene, *Sputter Deposition Processes, H. of deposition technologies for films and P. M. Martin ed., and p. 261. coatings, 3rd ed., Burlington, William Andrew publications, 2010, “<Sputter Deposition Processes_DeplaMahieuGreene.pdf>,”* vol. 281, pp. 1–36.
- [5] J. Sarkar, *Sputtering and Thin Film Deposition*, vol. 2. 2014. doi: 10.1016/b978-0-8155-1593-7.00002-3.
- [6] N. A. Kundari and S. Wiyuniati, “Tinjauan kesetimbangan adsorpsi tembaga dalam limbah pencuci pcb dengan zeolit,” *Semin. Nas. IV SDM Teknol. Nuiklir*, pp. 489–496, 2008.
- [7] J. T. Gudmundsson, “Physics and technology of magnetron sputtering discharges,” *Plasma Sources Sci. Technol.*, vol. 29, no. 11, 2020, doi: 10.1088/1361-6595/abb7bd.
- [8] S. Widodo, “Teknologi Pendeposisian Film Tipis Metal Dengan Metode Dc-Sputtering,” *Semin. Nas. Fis.*, p. 6, 2012.

- [9] S. H. Kiyotaka Wasa, *HANDBOOK OF SPUTTER DEPOSITION TECHNOLOGY*, vol. 1, no. 69. 1967.
- [10] E. N. Irawan *et al.*, “Penggunaan Metode DC Magnetron Sputtering dalam Pembuatan Lapisan Tipis Tipe N (AZO) Sebagai Modul Termoelektrik,” *J. Sains dan Seni ITS*, vol. 8, no. 1, pp. 1–6, 2019, doi: 10.12962/j23373520.v8i1.41915.
- [11] S. Kasus, C. V Dwi, and T. Bawen, “Metode Progresif Dengan Logika Fuzzy,” vol. 2, no. I, pp. 1–11, 2006.
- [12] S. N. Yahya, “Pembangkitan Plasma Menggunakan Metode Direct Current Magnetron Sputtering,” Institut Teknologi Kalimantan, 2019.

